

## 强一半导体（苏州）股份有限公司

### 关于增加合肥子公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：强一半导体（合肥）有限公司（以下简称“合肥子公司”）
- 投资内容：增加合肥子公司注册资本人民币2亿元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项已经强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次对合肥子公司增加注册资本尚需市场监督管理部门核准变更登记，合肥子公司在日常运营过程中需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。公司将及时关注市场变化，加强对子公司的管理，应对风险。敬请投资者注意投资风险。

#### 一、本次增资概述

##### （一）本次增资基本情况

##### 1、本次交易概况

为有效扩充公司产能，夯实公司主营业务根基，公司拟在合肥经济技术开发区投资建设强一半导体探针卡制造基地项目（以下简称“本项目”），本项目预

计投资总额为人民币 10 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>暨终止原投资协议的公告》。

为实现本项目专业化运营、精细化核算、规范化管理，公司拟向合肥子公司增资人民币 2 亿元并提请股东会授权公司管理层办理增资相关的工商变更等手续，计划用于前期土建及装修工程。本次增资完成后，合肥子公司的注册资本将变更为人民币 40,500 万元。

## 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	强一半导体（合肥）有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额：__人民币 2 亿元__ <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	<input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____

### （二）本次增资审批程序

公司于 2026 年 3 月 9 日召开了第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加合肥子公司注册资本的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

(三) 是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## 二、增资对象基本情况

(一) 增资对象的概况

1、增资对象基本情况

公司名称	强一半导体（合肥）有限公司
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	91340111MA8P07EY0C
法定代表人	周明
成立日期	2022年4月29日
注册资本	20,500万元
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区青龙潭路集成电路科技园C3栋一层北区和二层北区
经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；光电子器件制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料制造；特种陶瓷制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年6月30日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	16,904.85	10,467.32
负债总额	5,307.48	4,339.65
所有者权益总额	11,597.37	6,127.68

资产负债率	31.40%	41.46%
科目	2025年1-6月 (经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	1,825.16	4,461.08
净利润	-1,530.31	-421.22

注：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

上述合肥子公司财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 3、增资前后股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
强一半导体（苏州）股份有限公司	20,500	100	40,500	100

#### （二）出资方式及相关情况

公司拟以自有资金或自筹资金增资，不涉及募集资金。

### 三、本次增资对公司的影响

本次增资将增强合肥子公司的资金实力和运营效率，解决其发展资金需求，更快、更好地实现项目专业化运营、精细化核算、规范化管理，符合公司发展战略和长远规划。本次增加注册资本后，合肥子公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增加注册资本事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、本次增资的风险提示

本次对合肥子公司增加注册资本尚需市场监督管理部门核准变更登记，合肥子公司在日常运营过程中需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。公司将及时关注市场变化，加强对子公司的管理，应对风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月10日